

**Bruxelles, 9 septembrie 2025
(OR. en)**

**12656/25
ADD 1**

**ENV 815
MI 635
DELECT 125**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	8 septembrie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2025) 5939 final - Annex
Subiect:	ANEXĂ la Directiva delegată a Comisiei de modificare a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2025) 5939 final - Annex.

Anexă: C(2025) 5939 final - Annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.9.2025
C(2025) 5939 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Directiva delegată a Comisiei

**de modificare a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire
înaltă**

ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 7(a) se înlocuiește cu următorul text:

„7(a)	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult)	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 30 iunie 2027.
7(a)-I	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) pentru interconexiunile interne în scopul fixării cipurilor sau a altor componente împreună cu un cip într-un ansamblu de semiconductori cu curenți în regim staționar sau tranzitoriu/pulsat cu o intensitate mai mare sau egală cu 0,1 A sau tensiuni de blocare mai mari de 10 V sau dimensiuni ale marginii cipului mai mari de 0,3 mm x 0,3 mm	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.
7 (a) -II	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) pentru conexiunile integrale (adică interne și externe) de fixare a cipurilor în componentele electrice și electronice, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: - conductivitatea termică a materialului de fixare a cipului întărit/sinterizat este $> 35\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, - conductivitatea electrică a materialului de fixare a cipului întărit/sinterizat este $> 4,7\text{MS}/\text{m}$, - temperatura de topire solidus este mai mare de $260\text{ }^{\circ}\text{C}$	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.
7(a)-III	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) la îmbinările prin lipire de prim nivel (conexiuni interne sau integrale – adică interne și externe) pentru fabricarea componentelor, astfel încât montarea	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și

	ulterioară a componentelor electronice pe subansambluri (și anume module, plăci cu subcircuite, substraturi sau lipire în puncte) cu un aliaj de lipit secundar să nu retopească aliajul de lipit de prim nivel. Această subrubrică exclude aplicațiile de fixare a cipurilor și etanșările ermetice.	expiră la 31 decembrie 2027.
7(c)-IV	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) la îmbinările prin lipire de al doilea nivel pentru fixarea componentelor pe plăcile de circuite imprimate sau pe cadrele de plumb: 1. în bile de lipit pentru fixarea matricei de bile din ceramică (<i>ball-grid-array</i> - BGA) 2. în supraforme din materiale plastice la temperatură înaltă (> 220 °C)	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.
7(a)-V	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) ca material de etanșare ermetică între: 1. un pachet sau o fișă din ceramică și o carcasă metalică, 2. terminalele componentelor și o subparte internă	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.
7(a)-VI	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) pentru stabilirea conexiunilor electrice între componentele lămpilor din lămpile reflectorizante cu incandescență pentru încălzire în infraroșu, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată sau lămpile de cuptor	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.
7(a)-VII	Plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliajele de plumb cu conținut de plumb de 85 % din greutate sau mai mult) pentru traductori audio la care temperatura maximă de funcționare depășește 200 °C	Se aplică tuturor categoriilor (cu excepția aplicațiilor care intră sub incidența punctului 24 din prezenta anexă) și expiră la 31 decembrie 2027.”